



tesa® 70480

제품 정보

800µm 양면 화이트 Bond & Detach 테이프

제품 설명

tesa® 70480은 점착제를 늘려 쉽게 제거할 수 있는 양면 마운팅 테이프입니다.

특성

- 두께: 800µm
- 매우 높은 본딩 강도
- 높은 푸시아웃 및 내충격성
- 점착제를 늘려 쉽게 제거 가능
- 오랜 본딩 시간 후에도 잔여물 없이 제거
- LSE 기판에서도 고성능

Applications

- 전자 장치에 부품을 영구적으로 장착하는 용도로 쓰이며 쉽게 제거할 수 있음
- 생산 공정 중 전자 장치에 부품을 임시로 고정
- 노트북 및 All-In-One PC에 터치 패널 장착

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

기재 소재	없음	컬러	흰색
점착제 종류	특수	이형지 두께	72 µm
이형지 종류	글라신지	이형지 색깔	갈색
총두께	800 µm		

속성 / 성능 값

14일 경과 제거성 (23°C)	very good	장기간 온도저항	60 °C
단기간 온도저항	90 °C	정적 전단응력 (23°C)	very good
떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는	네	정적 전단응력 (40°C)	very good
무용제	네		



tesa® 70480

제품 정보

점착력(수치)

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------|
| • 알루미늄점착력 (초기) | 21 N/cm | • PE점착력 (초기) | 15 N/cm |
| • 알루미늄점착력 (14일 경과) | 21 N/cm | • PE점착력 (14일 경과) | 15 N/cm |
| • Magnesium 면의 점착력 (초기) | 19 N/cm | • Steel점착력 (초기) | 27 N/cm |
| • Magnesium 면의 점착력 (14일 경과) | 19 N/cm | • Steel점착력 (14일 경과) | 27 N/cm |

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://i.tesa.com/?ip=70480>